2010年9月期 決算説明会





Automobile Industry Electronics Industry

Nov 16, 2010

1/26



2010年9月期 業績結果について





2010年9月期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

			10/9期	09/9期	増減額	增減率
売	上	高	28,459	22,451	+6,007	+26.8%
売	上総利	益	8,009	3,937	+4,072	+103.4%
売	上総利益	率	28.1%	17.5%		+10.6P
販	管	費	5,715	5,454	+260	+4.8%
販	管 費	率	20.1%	24.3%		∆4.2P
営	業利	益	+2,294	-1,516	+3,811	+251.3%
営	業利益	率	+8.1%	-6.8%		+14.8P
経	常利	益	+2,379	-1,593	+3,972	+249.3%
経	常利益	率	+8.4%	-7.1%		+15.5P
当	期純利	益	+699	-2,990	+3,690	+123.4%
当	期純利益	車	+2.5%	-13.3%		+15.8P
OBA	L RA					

■ 売上高が回復

アジア地域での売上か回復したことな どにより、溶接・平面研磨両事業とも 売上が大幅に回復

■ 営業・経常利益が黒字転換

売上の増加と前期に実施した事業構造改革などによる固定費圧縮に伴い営業利益・経常利益とも急回復

■ 当期純利益が黒字転換

法人税等調整額8億48百万円を計上 したものの、当期純利益6億99百万 円の黒字決算

3/26

<連結>

OBARA



2010年9月期決算概要-②

連結損益計算書

■ セグメント別損益

(単位 百万円)

			溶接	増減額	平面研磨	増減額	合計	増減額
売	上	高	16,120	+2,840	12,338	+3,167	28,459	+6,007
売	上総利	益	4,547	+2,241	3,462	+1,830	8,009	+4,072
売	上総利益	率	28.2%	+10.8P	28.1%	+10.3P	28.1%	+10.6P
販	管	費	3,275	+231	2,439	+29	5,715	+260
販	管 費	率	20.3%	△2.6P	19.8%	△6.5P	20.1%	∆4.2P
営	業利	益	+1,272	+2,010	+1,022	+1,801	+2,294	+3,811
営	業利益	率	+7.9%	+13.4P	+8.3%	+16.8P	+8.1%	+14.8P

*上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません



2010年9月期決算概要-③

連結損益計算書

期末従業員数

■ 販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

					10/	9期	09/	9期	増減
					金額	売上比	金額	売上比	金額
人		件		費	2,748	9.7%	2,840	12.6%	Δ91
減	価	償	却	費	137	0.5%	194	0.8%	△57
運		送		費	487	1.7%	375	1.7%	+112
旅	費	交	通	費	303	1.1%	305	1.4%	Δ2
研	究	開	発	費	686	2.4%	625	2.8%	+61
そ		၈		也	1,351	4.7%	1,113	5.0%	+237
合				丰	5,715	20.1%	5,454	24.3%	+260

OBAR/A

1,533人 1,553人 △20人減

5/26

<連結>



2010年9月期決算概要-④

営業外損益

為替差損

55百万円(09/9 246百万円)

法人税等調整額

法人税等調整額 → 8億48百万円

(うち、子会社配当方針の見直しに伴う、子会社からの配当想定額 増額による繰延税金負債 9億13百万円)







2011年9月期の予想と グループの展望





<連結> FAM 2011年9月期業績予想 (通期連結) (単位 百万円) 11/9期予想 10/9期実績 増減額 増減率(色) 売 上 高 29.000 28.459 +540 +1.9% 売 上 総 利 益 8,000 8,009 Δ9 △0.1% 27.6% 28.1% 売上総利益率 △0.6P 販 管 5,700 5,715 Δ15 △0.3% 19.7% 20.1% ∆0.4P 販 管 費 率 益 +2,300 +2,294 +0.2% 業 利 営 業 利 益 率 +7.9% +8.1% **△**0.1P 利 益 +2,100 +2,379 **△279 △11.7%** +7.2% +8.4% 常利益率 Δ1.1P +1,700 期純利益 +699 +1,000 +143.1% 当期純利益率 +5.9% +2.5% +3.4P 10/26 OBARA



2011年9月期業績予想(上・下半期)

			11/9期 上半期予想	前同期比	11/9期 下半期予想	前同期比
売	上	高	14,300	+2,527	14,700	△1,987
売	上総利	益	4,000	+819	4,000	△829
売	上総利益	率	28.0%	+1.0P	27.2%	∆1.7P
販	管	費	2,870	+103	2,830	Δ118
販	管 費	搟	20.1%	∆3.4P	19.3%	+1.6P
営	業利	盐	+1,130	+715	+1,170	△710
営	業 利 益	₩	+7.9%	+4.4P	+8.0%	∆3.3P
経	常利	盐	+1,050	+490	+1,050	△769
経	常利益	搟	+7.3%	+2.6P	+7.1%	∆3.8P
当	期純利	益	+880	+1,537	+820	△536
当	期純利益	率	+6.2%	+11.7P	+5.6%	△2.6P

11/26

<連結>



2011年9月期業績予想(セグメント別)

(単位 百万円)

	溶接	前同期比	平面研磨	前同期比	合計	前同期比
売 上 高	13,800	Δ2,320	15,200	+2,861	29,000	+540
売上総利益	4,200	△347	3,800	+337	8,000	△9
売上総利益率	30.4%	+2.2P	25.0%	∆3.1P	27.6%	△0.6P
販 管 費	3,000	Δ275	2,700	+260	5,700	Δ15
販 管 費 率	21.7%	+1.4P	17.8%	△2.0P	19.7%	△0.4P
営業 利益	+1,200	△72	+1,100	+77	+2,300	+5
営業利益率	+8.7%	+0.8P	+7.2%	Δ1.1P	+7.9%	∆0.1P

*上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません



主な項目の実績と予想

(2010年9月期実績) (2011年9月期予想)

◆設備投資

763百万円

950百万円

◆ 減価償却費

811百万円

800百万円

◆ 研究開発費

779百万円

840百万円

◆ 銅価格

70万円/ton

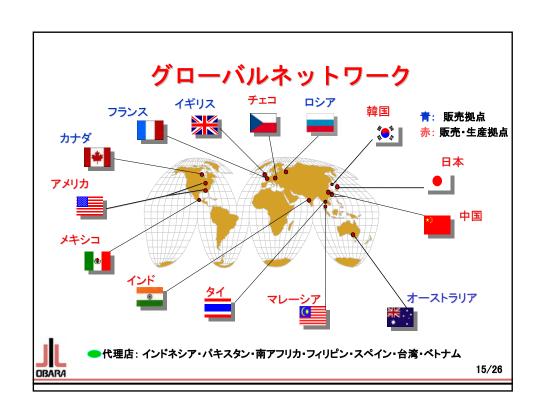
73万円/ton

◆ 為替想定レート

\$=80円 (1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)







溶接事業 2011年9月期業績予想

(単位 百万円)

			11/9期 上半期予想	前同期比	11/9期 下半期予想	前同期比	11/9期 通期予想	前同期比
売	上	高	6,900	△834	6,900	△1,485	13,800	△2,320
売	上総	削 益	2,100	Δ151	2,100	△195	4,200	△347
売	上総利	益 率	30.4%	+1.3P	30.4%	+3.1P	30.4%	+2.2P
販	管	費	1,520	Δ119	1,480	△156	3,000	△275
販	管 費	率	22.0%	+0.8P	21.4%	+1.9P	21.7%	+1.4P
営	業利	益	+580	Δ32	+620	△39	+1,200	△72
営	業 利 3	率益	+8.4%	+0.5P	+9.0%	+1.1P	+8.7%	+0.8P

*上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません









平面研磨事業の概況

- エレクトロニクス素材各社の増産を受け、 消耗副資材の販売が復調傾向
- ハードディスク業界などで積極的な 設備投資が実施され、装置販売が伸長
- ▶ 先端二一ズ対応への継続的な研究開発



平面研磨事業 2011年9月期業績予想

(単位 百万円)

							(李座 日27日)
		11/9期 上半期予想	前同期比	11/9期 下半期予想	前同期比	11/9期 通期予想	前同期比
売	上 髙	7,400	+3,361	7,800	△500	15,200	+2,861
売	上総利益	1,900	+971	1,900	△633	3,800	+337
売	上総利益率	25.7%	+2.7P	24.4%	∆6.2P	25.0%	∆3.1P
販	管 費	1,350	+223	1,350	+37	2,700	+260
販	管費率	18.2%	∆9.7P	17.3%	+1.5P	17.8%	△2.0P
営	業 利 益	+550	+748	+550	△670	+1,100	+77
営	業 利 益 率	+7.4%	+12.3P	+7.1%	∆7.7P	+7.2%	∆1.1P

*上記は参考数値であり、正式な開示数値ではありません

19/26

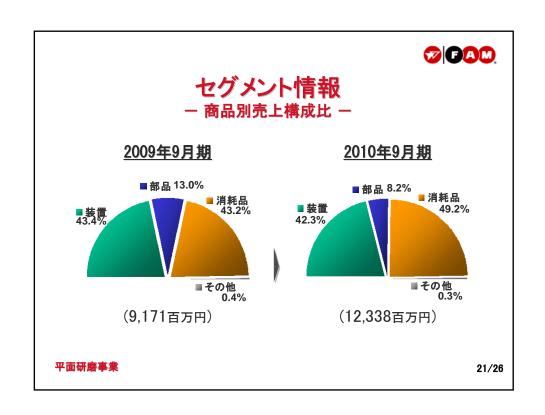


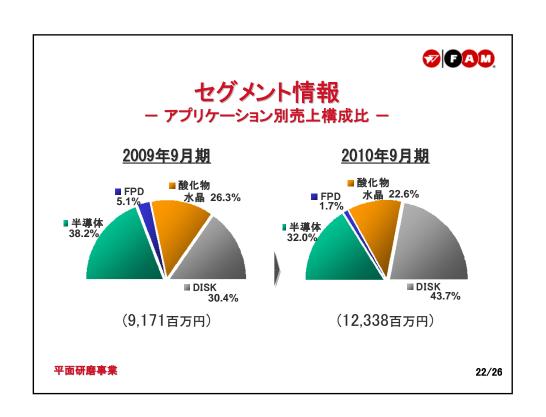


商品群

- 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置(エッジポリッシャー)
- **)** 洗浄装置
- ドライエッチャー装置(DCP)
- 🌶 消耗副資材(定盤・研磨剤・研磨布など)

平面研磨事業









主要項目の結果と展開

- > Si ウェーハ向け両面研磨装置 売上計上6億円と受注残高3億円
- ハードディスク向け装置 売上計上14億円と受注残高20億円
- 先端要求への技術革新に継続傾注2011年9月期 研究開発関連: 4.5億円を計画

平面研磨事業

